Also published

EP03280

US48534

EP03280

EP03280

# NEW SOLUBLE POLYIMIDE SILOXANE AND ITS MANUFACTURE AND USE

Patent number:

JP2036232

Publication date:

1990-02-06

Inventor:

CHIYUN JIEI RII

Applicant:

OCCIDENTAL CHEM CORP

Classification:

- international:

C08G73/10; C08J5/18; D01F6/74; D06M15/643

~ european:

Application number: JP19890030911 19890209 Priority number(s): US19880153898 19880209

Abstract not available for JP2036232 Abstract of correspondent: **EP0328027** 

Substantially fully imidized polyimidesiloxanes which are based on a mixture consisting essentially of a biphenyl tetracarboxylic dianhydride and a benzophenone tetracarboxylic dianhydride, are soluble in diglyme which gives them particular utility in the micro-electronics industry. The polymers are prepared from the mixture of dianhydrides, a difunctional siloxane monomer and an organic diamine. Diamines can be used to provide an asymmetrical structure in the polyimidesiloxane polymer chain. The polyimidesiloxane can be prepared with functional groups which render them directly curable. The polyimidesiloxanes can also be prepared with functional groups which when reacted with an unsaturated compound renders the polymers curable. The products of the invention can be used in the form of solutions in the micro-electronic industry. The polymers can also be used in wire and cable coating and to prepare films, fibers, and molded and extruded articles.

### 9日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

#### ② 公開特許公報(A) 平2-36232

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)2月6日

C 08 G 73/10 08 J 01 F 5/18 С 6/74 D

15/643

NTF CEZ 8830-4 J

8720-4 F 6791-4 L 7438-4L

審査請求 未請求 請求項の数 71 (全19頁)

の発明の名称

D 06 M

新規な可溶性ポリイミドシロキサン及びそれらの製造方法並びに使 用方法

> 頭 平1-30911 ②特

Z

願 平1(1989)2月9日 22出

優先権主張

@1988年2月9日@米国(US)@153898

稔

加発 明 者

1J — チュン ジエイ

アメリカ合衆国 ニユーヨーク州 イースト アムハース

ト プランテーション コート 121

オクシデンタル ケミ ⑪出 頤 人

アメリカ合衆国 ニューヨーク州 14302 ナイアガラ

カル コーポレーショ

フォールズ バツフアロー アベニュー アツト フォー

テイセブンス ストリート (番地なし)

個代 理 人 弁理士 中村

外8名

### 明細香の浄魯(内容に変更なし)

細

1. 発明の名称

新規な可溶性ポリイミドシロキ サン及びそれらの製造方法並び に使用方法

#### 2.特許請求の範囲

(1) 有機ジ酸無水物、二官能シロキサンモノマー、 及び有機ジアミンの反応生成物を含む実質的に 充分イミド化されたポリイミドシロキサンに於 いて、

ポリイミドシロキサンがジグライムに可溶性 であり、有機ジ酸無水物がピス(ジカルボキシ フェニル)ヘキサフルオロプロペンジ酸無水物 を含むことを特徴とする、上記のポリイミドシ ロキサン。

- (2) 有機ジ酸無水物が2, 2-ビス(3', 4' - ジカルボキシフェニル) ヘキサフルオロプロ パンジ酸無水物である請求項(1)記載のポリイミ
- (3) オキシジフタル酸無水物を更に含み、ビス (ジカルボキシフェニル) ヘキサフルオロプロ

ペンジ酸無水物対オキシジフタル酸無水物のモ ル比が前者約9部対後者1部~前者約0.1部対 後者 1 部の範囲内である、請求項(1)記載のポリ イミドシロキサン。

- (4) オキシジフタル酸無水物が4,4′-オキシ . ジフタル酸無水物である、請求項(3)記載のポリ イミドシロキサン。
- (5) ピフェニルテトラカルボン酸ジ無水物を更に 含み、ビス (ジカルボキシフェニル) ヘキサフ ルオロプロペンジ酸無水物対ビフェニルテトラ カルボン酸ジ無水物のモル比が前者9部対後者 1部~前者約0.5部対後者1部の範囲内である、 請求項(1)記載のポリイミドシロキサン。
- (6) ピフェニルテトラカルボン酸ジ無水物が3. 3′. 4, 4′-ピフェニルテトラカルポン酸 ジ無水物である、請求項(5)記載のポリイミドシ ロキサン。
- (7) 有機ジアミンがポリイミドシロキサンポリマ -鎖中に非対称構造を与える、請求項(1)記載の ポリイミドシロキサン。

#### (8) 有機ジアミンが、

式 X NH z X NH z

(式中、x、y及びzは、x、y及びzの全部が水素ではないという条件で、独立に水素、ハロゲン、1~12個の炭素原子のアルキルもしくはハロゲン化アルキルまたは6~12個の炭素原子のアリールもしくはハロゲン化アリールである)を有する、請求項(1)記載のポリイミドシロキサン。

- (9) ×、y及びzが独立に水素、ハロゲン、1~ 12個の炭素原子のアルキルまたは6~12個 の炭素原子のアリールから選ばれ、但し×、y 及びzの全部は水素ではない、請求項(8)記載の ポリイミドシロキサン。
- 00 有機ジアミンが2. 4-トリルジアミン、2. 6-トリルジアミンまたはこれらの混合物であ
- 63 有機ジアミンがp.p-オキシジアニリン、また、はm,m-メチレンジアニリンである、請求項は記載のポリイミドシロキサン。
- 60 有機ジアミンが3,3′-スルホンジアニリンである請求項回記載のポリイミドシロキサン。
- 03 有機ジアミンが、

を有する、請求項の記載のポリイミドシロキサン。

0日 有機ジアミンの少なくとも一部が

(式中、Arは芳香族基であり、R \* はヒドロキシル、カルボキシル、またはヒドロチオールの少なくとも一つである)を有する、請求項(1)記載のポリイミドシロキサン。

る請求項(1)記載のポリイミドシロキサン。

- gD 有機ジアミンが約80重量%の2.4-トリルジアミン及び約20重量%の2.6-トリルジアミンの混合物である請求項(1)記載のポリイミドシロキサン。
- 02) 有機ジアミンが、

(式中、x は 
$$-CH_z$$
-、 $-\stackrel{\circ}{\underset{\circ}{\mathbb{I}}}$ -、0、 $\stackrel{\circ}{\underset{\circ}{\mathbb{C}}}$ 、

である)を有する、請求項(I)記載のポリイミド シロキサン。

- OT R がカルボキシルである、請求項の記載の ポリイミドシロキサン。
- (18) 有機ジアミン成分の少なくとも一部が、

(式中、Arが芳香族基であり、R " がアクリル 含有基、エチレン含有基またはアセチレン含有 基の少なくとも一つである) を有する、請求項 (1)記載のボリイミドシロキサン。

- 03 シロキサンモノマーがシロキサンジアミンである請求項(1) 記載のポリイミドシロキサン。
- 00 シロキサンジアミンが、

$$H_2N-R' \leftarrow \begin{pmatrix} R_1 & R_2 \\ \vdots & \vdots & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} R_2 & \vdots & \vdots \\ S_1 & \vdots & \vdots \\ R_2 & \vdots & \vdots \\ R_4 & \vdots & \vdots \end{pmatrix}$$

(式中、R'は独立に1~12個の炭素原子の 置換もしくは無置換の脂肪族二官能基または6 ~10個の置換もしくは無置換の芳香族二官能 基から選ばれ、R,、R,、R,及びR。の一 つ以上がピニル基、ヒドロキシル基、アクリル 含有基、エチレン含有基、またはアセチレン含 有基であり、R、、R、、R、及びR。の残部 が独立に1~12個の炭素原子の置換もしくは 無置換の脂肪族一官能基または6~10個の炭 素原子の置換もしくは無置換の芳香族一官能基 から選ばれ、mは約5~200の数である)を 有する、請求項の記載のポリイミドシロキサン。

- (21) R. 、R. 、R. 及びR. がメチル基であ る、請求項如記載のポリイミドシロキサン。
- (22) R′が (- C Hz-) ;である、請求項(21) 記載のポリイミドシロキサン。
- (23) 上記の式のシロキサンジアミンの少なくと も一部は、RI、RI、RI及びRIの少なく とも一つがヒドロキシルまたはビニルから選ば れた基であるジアミンを含む、請求項頭記載の ポリイミドシロキサン。
- (24) R. 、R. 、R. 及びR. の少なくとも一 つがピニルであり、残部がメチル基である、請 求項(23)記載のポリイミドシロキサン。

もl部は、Ri、Ri、Ri及びRiの少なく とも一つがアクリル含有基、エチレン含有基、 またはアセチレン含有基から選ばれたシロキサ ンジアミン成分を含む、請求項四記載のポリイ ミドシロキサン。

記載のポリイミドシロキサン。

(27) アクリル含有基を含む、請求項(26)記載の ポリイミドシロキサン。

(25) R′が (-СH<sub>2</sub>-) ;である、請求項(24)

(26) 上記の式のシロキサンジアミンの少なくと

- (28) シロキサンモノマーがシロキサンジ酸無水 物である、請求項(1)記載のポリイミドシロキサ ン。
- (29) シロキサンジ酸無水物が、

式

(式中、 Rは1~12個の炭素原子の置換もし くは無置換の脂肪族三官能基または6~10個 の炭素原子の置換もしくは無置換の芳香族三官 能基であり、Rı、Rì、Rı及びR。の一つ 以上がハロゲン、ハイドライド(H)、ピニル 基、ヒドロキシル基、アクリル含有基、エチレ ン含有基、またはアセチレン含有基であっても よく、RI、RI、RI及びRIの残部が独立 に1~12個の炭素原子の置換もしくは無置換 の脂肪族一官能基または6~10個の炭素原子 の置換もしくは無置換の芳香族一官能基から選 ばれ、mが約5~50である)を有する、請求 項(28)記載のポリイミドシロキサン。

(30) R. 、R. 、R. 及びR. がメチル基であ る、請求項(29)記載のポリイミドシロキサン。

である、請求項(30)記載のポリイミドシロキサ ν.

- (32) 上記の式のシロキサンジ酸無水物の少なく とも一部は、RI、RI、RI及びRIの少な くとも一つがハイドライド(H)、ハロゲン、 ヒドロキシルまたはビニルから選ばれた基であ るジ酸無水物を含む、請求項(29)記載のポリイ ミドシロキサン。
- (33) R, 、R: 、R: 及びR: の少なくともー つがピニルであり、残部がメチル基である、請 求項(32)記載のポリイミドシロキサン。

(34) Rが

である、請求項(33)記載のポリイミドシロキサ ν.

(35) 上記の式のシロキサンジ酸無水物成分の少 なくとも一部は、R,、R,、R,及びR。の 少なくとも一つがアクリル基、エチレン基また はアセチレン基から選ばれた基であるシロキサ ンジ酸無水物成分を含む、請求項(29)記載のポ リイミドシロキサン。

- (36) アクリル含有基を含む、請求項(35)記載の ポリイミドシロキサン.
- (37) 有機ジアミン、二官能シロキサンモノマー、 及びピス (ジカルボキシフェニル) ヘキサフル オロプロペンジ酸無水物を含む有機ジ酸無水物 を反応させることを特徴とする、ジグライムに 可溶性であるポリイミドシロキサンの製造方法。
- (38) 反応混合物が更にオキシジフタル酸無水物 を含む、請求項(37)記載の方法。
- (39) 反応混合物が更にピフェニルテトラカルボ ン酸ジ無水物を含む、讀求項(37)記載の方法。
- (40) 反応がポリイミドシロキサン用溶媒中で行 なわれる、請求項(37)記載の方法。
- (41) 溶媒がジグライム、トリグライム、1-メ チルー2-ピロリジノン、テトラヒドロフラン、 メチルエチルケトン、フェノール類またはこれ らの混合物から選ばれる請求項(40)記載の方法。

(42) シロキサンモノマーがシロキサンジアミン である、請求項(37)記載の方法。

(43) シロキサンモノマーが、

$$H_z N - R' \leftarrow \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ S_i - 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} R_3 \\ \vdots \\ S_i - R' - NH_z \end{pmatrix}$$

(式中、R'は独立に1~12個の炭素原子の 遺換もしくは無置換の脂肪族二官能基または6 ~10個の炭素原子の置換もしくは無置換の芳 香族二官能基から選ばれ、RI、RI、RI及 びR。の一つ以上がピニル基、ヒドロキシル基、 アクリル含有基、エチレン含有基またはアセチ レン含有基であってもよく、RI、RI、RI 及びR。の残部が独立に1~12個の炭素原子 の置換もしくは無置換の脂肪族一官能基または 6~10個の炭素原子の置換もしくは無置換の 芳香族一官能基から選ばれ、mが約5~約50 の整数である) を有するシロキサンジアミンで

#### ある、請求項(37)記載の方法。

- (44) R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>及びR<sub>4</sub>がメチル基であ る、請求項(43)記載の方法。
- (45) R′が (-СН2-),である、請求項(44) 記載の方法。
- (46) シロキサンモノマーがシロキサンジ酸無水 物である、請求項(37)記載の方法。
- (47) シロキサンモノマーが、

(式中、1~12個の炭素原子の置換もしく は無置換の脂肪族三官能基または6~10個の 炭素原子の置換もしくは無置換の芳香族三官能 基であり、R、、R、、R、及びR、の一つ以 上がハロゲン、ハイドライド(H)、ビニル基、 ヒドロキシル基、アクリル含有基、エチレン含 有基、またはアセチレン含有基であってもよく、 R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>及びR<sub>4</sub>の残部が独立に1~ 12個の炭素原子の置換もしくは無置換の脂肪 族一官能基または6~10個の炭素原子の置換 もしくは無置換の芳香族一官能基から選ばれ、 mが約5~約50である)を有する、シロキサ ンジ酸無水物である、請求項(46)記載の方法。

(48) R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>及びR<sub>4</sub>がメチル基であ る、請求項(47)記載の方法。

である、請求項(48)記載の方法。

(50) 有機ジアミンの少なくとも一部が、

(式中、Arは芳香族基であり、R\*がヒドロキ

シル、カルボキシル、またはヒドロチオールの 少なくとも一つである)を有する、請求項(37) 記載の方法。

- (51) R \* がカルポキシルである、請求項(50)記 敬の方法。
- (52) 上記の式のシロキサンジアミンの少なくと も一部は、RI、RI、RI及びRIの少なく とも一つがヒドロキシルまたはピニルから選ば れた基であるジアミンを含む、請求項(43)記載 の方法。
- (53) R, 、R, 、R, 及びR, の少なくとも-つがビニル基であり、残部がメチル基である、 請求項(52)記載の方法。
- (54) R'が (- C H<sub>2</sub>-) っである、請求項(53) 記載の方法。
- (55) 上記の式のシロキサンジ酸無水物の少なく とも一部は、RI、RI、RI及びRIの少な くとも一つがハイドライド ( H ) 、ハロゲン、 ヒドロキシル、またはビニルから選ばれた基で あるジ酸無水物を含む、請求項(47)記載の方法。

- (56) R. 、R. 、R. 及びR. の少なくともー つがビニルであり、残部がメチル基である、請 求項(55)記載の方法。
  - (57) Rが





である、讀求項(56)記載の方法。

- (58) 上記の方法の生成物がアクリル含有基、エ チレン含有基またはアセチレン含有基の少なく とも一つを含む化合物と反応させられる、請求 項(50)記載の方法。
- (59) 上記の方法の生成物がアクリル含有基、エ チレン含有基またはアセチレン含有基の少なく とも一つを含む化合物と反応させられる、請求 項(52)記載の方法。
- (60) 上記の方法の生成物がアクリル含有基、エ チレン含有基またはアセチレン含有基の少なく とも一つを含む化合物と反応させられる、請求 項(55)記載の方法。
- (61) ポリイミドシロキサン用溶媒中に溶解され た請求項(1)記載のポリイミドシロキサンを含む (71) 請求項(35)の硬化組成物。 ことを特許とする溶液。
- (62) 溶媒がジグライム、トリグライム、1-メ チルー2ーピロリジノン、テトラヒドロフラン、 メチルエチルケトン、フェノール類または塩素 化溶媒から選ばれる、請求項(61)記載の溶液。
- (63) 請求項(1)記載のポリイミドシロキサンで被 覆された基材を含むことを特徴とする物品。
- (64) 基材がワイヤーまたはケーブルである、請 求項(63)記載の物品。
- (65) 請求項(1)記載のポリイミドシロキサンから 製造されたフィルム。
- (66) 請求項(1)記載のポリイミドシロキサンから 製造された繊維。
- (67) 請求項(1)記載のポリイミドシロキサンから 製造された成形品。
- (68) 請求項(1)記載のポリイミドシロキサンから 製造された押出成形品。
- (69) 請求項(1)の硬化組成物。

- (70) 請求項(26)の硬化組成物。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### (発明の産業上の利用分野)

本発明は、新規な可溶性のポリイミドシロキサン及びそれらの製造方法及び使用方法に関する。 (従来の技術とその問題点)

ボリイミドとして知られるボリマー類は、その 良好な然安定性とガラス転移温度により測定され るように高い使用温度との組合せについて知られ るようになってきた。このようなボリイミドの特 に有用な型はボリイミドシロキサンとして知られ る。

それらの性質の組合せにより、ポリイミドシロキサンは電気用途、特にコンピューター工業の超小形電子部品に使用されてきた。

既知のポリイミドシロキサンの殆どはマイクロエレクトロニクス工業に於いて使用される時溶媒に不溶性または難溶性であるため、改良された溶解性並びに耐熱性と高い使用温度との一層良好なパランスを有するポリイミドシロキサンに対する多大な要望がある。

ボリィミドをつくるための化学は約1960年 以来公知であった。構造的に簡単なポリイミドは ジアミンをジ酸無水物と反応させることにより調 製し得る。

第一工程、即ち重縮合反応は、室温でさえ加水 分解に対し不安性であるポリアミド酸を生じる。 第二工程、即ちィミド化反応は、種々の用途に所 望な安定なポリィミドを生成する。

ポリイミドシロキサンは、有機コモノマーと共 にシロキサンジアミンまたはシロキサンジ酸無水 物を用いる反応により調製し得る。またポリイミ ドシロキサンは、有機コモノマーを用いずにシロ キサンジアミン及びシロキサンジ酸無水物から調 製し得る。

第一のポリイミドシロキサンは、1966年にピロメリット酸ジ無水物(PMDAと称する)を1、3ーピスー(アミノプロピル)-1、1、3、3ーテトラメチルジシロキサンと反応させることにより調製された(V.H.クッカーツ(Kuckertz) 著、Macromol、Chem、98巻、101~108頁、1966年を参照のこと)。このポリイミドシロキサンは結晶物質であり、溶媒により可提性フィルムに注型し得ない。ベンゾフェノンテトラカルポン酸ジ無水物(BTDAと称する)及びα、ω

ージアミノオルガノポリシロキサンの反応から誘導されるポリイミドシロキサンは、米国特許第3,325.450 号に於いて1967年にゼネラル・エレクトリック(General Electric)社により開示された。またα、ωージアミノオルガノポリシロキサン及びジェーテルジ酸無水物(DEDAと称する)を含むポリイミドシロキサンが米国特許第3,847,867 号に開示されている。

これらのBTDA及びDEDAを含むポリイミドシロキサンは全て無定形物質である。それらは100℃以下のガラス転移温度を有し、それ故約200℃までのこれらのポリマーの優れた然安定性にかかわらず極めて制限された上限の使用温度を有する。

有機モノマー及びシロキサンモノマーの両者を含むボリィミドシロキサンがPMDA含有ボリマー(特開昭第58-7473号及び同第58-13631号を参照のこと)、BTDA含有コボリマー(米国特許第3.553,282号及び同第4.404,350号を参照のこと)、及びジエー

テルジ酸無水物含有コポリマー(米国特許第 3.8 47.8 6 7 号を参照のこと) に関して報告さ れている。これらのPMDA含有ポリイミドシロ キサンは溶媒に可溶性ではない。 BTDA含有ポ リィミドシロキサンは、普通N-メチルピロリド ン (NMPと称する) として知られる1-メチル - 2 - ピロリジノン、フェノール、またはクレゾ - ル等の如き、高沸点もしくは毒性の溶媒にわず かに可溶性である。更にまた、ジェーテルジ酸無 水物含有ポリイミドシロキサンはジクロロベンゼ ン及びジクロロメタンの如き塩素化溶媒に可溶性 である。これらのフェノール化合物及び塩素化化 合物は腐蝕性でしかも非常に毒性であるので、ポ リイミドシロキサンは被覆用途、特に感熱性電気 装置に於いて制限された用途を有していた。これ はまたNMP可溶性ポリイミドシロキサンが通常 少なくとも30分間350℃に加熱されてミクロ ンの膜厚を有するフィルム中に残留する溶媒を全 て除去しなければならいという事実による。

ポリイミドポリシロキサンのポリアミド酸の殆

どが可溶性であるという事実にかかわらず、ごく わずかのポリイミドシロキサンが1-メチル-2 - ピロリジノン (NMP) の如き高沸点で比較的 森性の溶媒中に可溶性である。被覆用途に於ける ポリアミド酸の使用は多くの欠点を有している。 第一に、ひき続く基材上のイミド化反応は水を生 じる。それ故、それは極めて薄膜の被覆物であっ てポイドのない性質が性能に重要ではない被覆物 にのみ使用し得る。第二に、NMPの如き高沸点 の極性溶媒の除去はミクロンの厚さのフィルムで あっても約30分間で350℃程度に高い温度を 必要とする。この乾燥方法はエネルギーを増大す るのみならず、或種の感熱性電気装置または基材 には許容し得ない。更に、ポリアミド酸溶液は冷 却温度 (く4で) で貯蔵しなければならず、それ は極めて短かい貯蔵寿命(約3ヶ月)を有してい る。最後に、充分にイミド化されたポリイミドシ ロキサンのみが押出成形及び射出成形の如き溶融 処理に対して熱的に安定である。可溶性ポリイミ ドシロキサンは溶媒中で約160~170℃の温

度で充分イミド化することができ、一方固体状態の不溶性ポリイミドシロキサンのイミド化は 200~250 で程度に高いことがあるガラス転移温度より50 で高い温度を必要とすることがある。溶融処理法による充分イミド化されていないポリイミドシロキサンの成形は生成物中にポイドを生じ、しばしば望ましくない。

米国特許第4.290.936号はフェノールまたはハロゲン化フェノール化合物の存在下でピフェニルテトラカルボン酸と少なくとも50%のジアミノジフェニルエーテルを含む芳香族ジアミン成分とを反応させることによるボリイミドの調製を記載している。ベンゾフェノンテトラカルボン酸を含む追加のジ酸がまた使用し得る。シロキサンは生成されない。

米国特許第4,520,075号はピフェニルテト ラカルボン酸ジ無水物に基きポリイミドシロキサンが部分イミド化されるジグライム可溶性ポリイ ミドシロキサンを記載している。相当するポリア

ミド酸及び充分にイミド化された生成物は不溶性 である。ポリイミドシロキサン前駆体は、被覆用 途に使用される時には、イミド化されついで溶媒 が350でまたは400で程度の高温で30分間 で除去されなければならない。高温の使用は感熱 性半導体装置並びにハイブリッド回路に於いてそ れらの用途を制限した。加えて、これらの前駆体 は室温で加水分解に対して不安定であり 4 ℃の冷 却温度でさえも約3ヶ月のごく限られた貯蔵寿命 を有している。更に、これらの前駆体はイミド化 中に水を生じるか、あるいは膜厚が数ミクロンメ - ターを越える(> 2 0 μm) 時、被覆物中に泡を 生じる。ポリイミドシロキサン前駆体は薄膜用途 には有用ではない。ジアミノシロキサンは全ジア ミノ化合物の1~4モル%の量で使用される。通 常の使用は60モル%程度までの全ジアミノ成分 を基準として少なくとも約15モル%のシロキサ ン成分である。

米国特許第4.634.760号はピフェニルテト ラカルボン酸ジ無水物とベンゾフェノンテトラカ ルボン酸ジ無水物、オキシジフタル酸無水物または同特許の 1 間 6 0 行~ 3 間 5 行に開示される種々のその他のジ酸無水物であってもよい第二の酸無水物とに基くボリイミドに関する。この特許は1.3 - ビス(3 - アミノプロピル)テトラメチルジシロキサンを含む種々のジアミンの使用を開示しているが、ジグライム可溶性ボリイミドシロキサンを製造することを開示していない。

米国特許第4.586.997 号及び同第4.670.497 号に開示されているような、或種のジェーテルジ酸無水物含有ポリィミドシロキサンはジグライムフラン(Tb=60℃)に可溶性でありテトラヒドロフラン(Tb=60℃)にわずかに可溶性でありおしてありが、これらのポリイミドシロキサンのいずれもが被理工業に最も使用される溶媒の一つであるメチルエチルケトン(Tb=80℃)の如き溶媒にマミドシロキサンは全て比較的低いガラス転移温度ではない。しかしながら、これらのポリイミドシロキサンは全て比較的低いガラス転移温度ではない。125℃~150℃以下)及び限られた熱安定性(フィルム可提性及び一体性を保持して350℃

# ✓ 0.5 時間)を有する。ジグライムまたはメチルエチルケトンの如き無毒性で低沸点の溶媒に可溶性である熱安定性のポリイミドシロキサンはこれらのジェーテルジ酸無水物から容易に得ることができない。

ベーガー(Berger)の米国特許第4.3 95.5 2 7 号は、ポリイミドシロキサンを製造するのに有用な多数の種々の成分を開示している。この特許に於いて、BPDA及びBTDAの両者が有用なジ酸無水物として開示されているが、米国特許第4.5 2 0.0 7 5 号及び同第4.6 3 4,7 6 0 号の特許権者の如きその他の研究者らは、BPDA及びBTDAの夫々の使用はジグライムに可溶性であるポリィミドシロキサンをもたらさないことを示した。更に、本発明に使用されるトリレンジアミンはこの引用特許に開示されていない。

米国特許第4.586.997 号及び同第4.670.497 号 はジェーテルジ酸無水物、ジアミン及びα, ωー ジアミノシロキサンに基くポリイミドシロキサン を製造することの有用性を数示する。ベンゾフェ ノンテトラカルボン酸ジ無水物(BTDAと称する)の使用が開示されているが、例示の実施例はBTDAに基くポリイミドがジグライムに可溶性ではないことを示す。また架橋ポリマーが開示されている。

下記の三つの米国特許は、ポリイミドの調製に 於ける化合物 2. 2 - ピス (3 '. 4 ' - ジカル ボキシフェニル) ヘキサフルオロプロパンジ酸無 水物 (6 F D A と称する) の使用を開示している。

米国特許第3、4 2 4、7 1 8 号は実施例 5 に於いて化合物 6 F D A 及びピロメリット酸ジ無水物を二つのジアミンと反応させることによるポリイミ がの調製を開示している。これは特別の教示であるようであり、その結果この特許は 6 F D A 単独または 6 F D A とその他の混合物の使用を開示していない。シロキサンは開示されていない。

米国特許第4,588.804号に於いて、ポリイミドは好ましくは二つのジ酸無水物を有機アミンと反応させることにより調製される。50~100

米国特許第4.612.361号は式(A)。(B)1---(式中、Aは特徴的な --- OZO--- 架橋を有する芳香族ピス (エーテル酸無水物) である)を有するポリイミドの調製を開示している。このような化合物のホストはこの特許の6個29行~44行に開示されている。成分日は6ドージ酸無水物(6FDA)である。背景の開示がその特許の6

ミド化されたボリイミドの問題にある。本学の内に基ででは、、イマーにとで、の自己のボリののが、リークを開発をできる。本学ののが、リークを開発をできる。本学ののが、リークを開発をできる。本学ののでは、リークを対して、は、大学のでは、アールを関系をは、アールを関系をは、アールを関系をは、アールを関系をは、アールを関系をは、アールを関系をは、アールを関系をは、アールを関系をは、アールを関系をは、アールを関系をは、アールを関系をは、アールを関系をは、アールを関系をは、アールを関系をは、アールを関係をは、アールをは、アールをは、アールをは、アールをは、アールをは、アールをは、アールをは、アールをは、アールをは、アールをは、アールをは、アールをは、アールをは、アールを表し、アールを表しまする。アールを表しまする。アールを表しまする。アールを表しまする。アールを表しまする。アールを表しまする。アールを表しまする。アールを表しまする。アールを表しまする。アールを表しまする。アールを表しまする。アールを表しまする。アールのでは、アールを表しまする。アールを表しまる。アールを表しまする。アールを表しまする。アールを表しまする。アールを表しまする。アールを表しまする。アールを表しまする。アールをまる。アールを表しまする。アールをまる。アールを

本発明の別の目的は、NMPの如き高沸点溶媒 に可溶性であるのみならずジグライムまたはテト ラヒドロフラン(THF)の如き低沸点の低低テ で一層極性がない溶媒にも可溶性である充分くこと ド化されたポリイミドシロキサンを提供すること である。本発明の別の目的は、耐熱性とガラスを 移温度で測定して高い使用温度との良好なバラと スを有するポリイミドシロキサンを提供すること 欄45行~68行に示されている。組成物は酸無水物と7欄5行~8欄14行に開示されているような有機ジアミンとの反応によりつくられる。化合物ピス(4-アミノブチル)テトラメチルジシロキサンが8欄12行に付随的に開示されている。

本件出願人の米国特許出願第 0 3 2, 7 2 2 号 (1987年 3 月 3 1 日出願) は、オキシジフタル酸無水物からつくられた充分にイミド化されたポリイミドシロキサンがジグライム、テトラヒドロフラン及びメチルエチルケトンの如き溶媒に可溶性であることを開示している。

本件出願人の本件出願と同日出願の特許出願はピフェニルテトラカルボン酸ジ無水物とベンプフェノンテトラカルボン酸ジ無水物との混合物からつくられた実質的に充分イミド化されたポリイミドシロキサンがジグライム、テトラヒドロフラン及びメチルエチルケトンの如き溶媒に可溶性であることを開示している。

本発明の目的の一つは、ジグライムの如き低沸点で非極性で無毒性の溶媒に可溶性である充分イ

である.

本発明の別の目的は、低い誘電率を有するポリ イミドシロキサンを提供することである。

本発明の別の目的は、硬化性のポリイミドシロキサンを促 キサン及び架橋されたポリイミドシロキサンを提 供することである。

(発明の要約)

を有するピス(ジカルボキシフェニル)へキサフルオロプロペンジ酸無水物に基く実質的に充分イミド化されたポリイミドシロキサンはジグライムに可溶性であり、これはそれらにマイクロエレクトロニクス工業に於ける特別な有用性を与える。 ポリマーはジ酸無水物、二官能シロキサンモノマ - 及び好ましくはポリイミドシロキサンポリマー 額に非対称構造を与える有機ジアミンから調製される。

フッ器化ジ酸無水物はオキシジフタル酸無水物 及びピフェニルテトラカルボン酸ジ無水物の如き その他のジ酸無水物と混合して使用し得る。ジ酸 無水物成分はジグライムに可溶性であるボリイミ ドシロキサンを与え得るものでなければならない。

本発明のポリイミドシロキサンは、それらを直接硬化性にする官能基を備えて調製し得る。またポリイミドシロキサンは不飽和化合物と反応させられる時にポリマーを硬化性にする官能基を備えて調製し得る。

本発明の生成物は、マイクロ電子工業に於いて 溶液形態で使用し得る。またポリマーは、ワイヤ ー及びケーブルの被覆及びフィルム、繊維、及び 成形品、押出成形品の製造に使用し得る。

(本発明の具体的な内容)

#### 有機酸無水物

本発明はピス (ジカルボキシルフェニル) ヘキ

オキシジフタル酸無水物は、3、3 ′ - オキシジフタル酸無水物、3、4 ′ - オキシジフタル酸無水物、及び4、4 ′ - オキシジフタル酸無水物 (4、4 ′ - ODPA) を含み、後者が最も好ましい化合物である。

BPDAは2.2′.3.3′ーピフェニルテトラカルボン酸ジ無水物、2.3.3′.4′ーピフェニルテトラカルボン酸ジ無水物及び3.3′.4.4′ーピフェニルテトラカルボン酸ジ無水物(3.3′.4.4′ーBPDAと称する)を含み、後者が最も好ましい化合物である。

○ D P A が使用される場合、モル比は一般に6 F D A 約 9 部対 ○ D P A 1 部 ~ 6 F D A 約 0.1 部対 ○ D P A 1 部 ~ 6 F D A 約 0.1 部対 ○ D P A 1 部の範囲内にある。B P D A が使用される場合、モル比は一般に6 F D A 約 9 部対 B P D A 1 部の範囲内にある。

その他の有機ジ酸無水物は、6FDAに対し約5~約20重量%までの少比率で使用し得る。

その他の有機ジ酸無水物は、以下の一般式を有

サフルオロプロペンジ酸無水物(6 F D A )の使用が可溶性と熱的性質との特異な組合せを有する充分にイミド化されたポリイミドシロキサンを与えるという発見に基く。

2.2-ビス(3 '.4'-ジカルボキシフェニル)へキサフルオロプロパンジ酸無水物(2.2-3'.4'-F6DAと称する)はピロメリット酸ジ無水物系ポリマーをつくるのに有用であると報告されている公知の化合物である。例えば米国特許第3,424.718号(実施例5)を参照のこと。2.2-3'.4'-F6DAは報告された操作、例えばオラング特許出願第6.406.896号(1964年12月18日公開、(CA62:145856(1965年))の操作に従って当業者によりつくることができる。上記の操作はれている。

6 F D A はオキシジフタル酸無水物 (O D P A) 及びピフェニルテトラカルボン酸ジ無水物(BPDA) の如きその他のジ酸無水物と共に使用し得る。

する化合物を含む。

(式中、Mはフェニレンまたは

C(CF<sub>3</sub>) z であり、

m=Oまたは1)

特別の例は下記の式を有するジェーテルジ酸無 水物である。

このようなその他のジ酸無水物のその他の例は 米国特許第4、395、527 号及び同第4、586、997 号に 開示されており、これらの開示は参考として本明 細番に含まれる。しかしながら、これらのジ酸無 水物の混入が生成ポリイミドシロキサンのNMP またはジグライム中の溶解性をごくわずか変え伊 るとしても、これらの変性ポリイミドシロキサン はMEKまたはTHFの如き溶媒に不溶性になる ことがある。これは、MEKの如き極めて低沸点

の無罪性溶媒が必要とされるそれらの用途を制限する。更にまた、式 I のようなジェーテルジ酸無水物(D E D A)の混入は本発明のポリイミドシロキサンのガラス転移温度及び熱安定性を低下し、それらの上限使用温度を制限する。かくして、約5重量%までのPMDA及び約20重量%までのジェーテルジ酸無水物(D E D A)が本発明の組成物中に使用し得る。

#### 有機ジアミン

ポリイミドシロキサン鎖中に非対称構造を与えるジアミンは、本発明の望ましく優れた性質をもつポリイミドシロキサンをつくるのにオキシジフタル酸無水物と組合せて特に有用であることがわかった。

ポリイミドシロキサン領中に非対称構造を与える好適なジアミンは下記の式を有している。

ポリマー鎖中で非対称であるその他の有用なジ

アミンは、下記の式をもつ化合物を含む。

である)

これらの例はm. m-メチレンジアニリン、m. m-スルホンジアニリン、o. m-スルホンジアニリンである。

ポリィミドシロキサン中で非対称である別の好 適なジアミンはジアミノアントラキノンである。

特に好ましいジアミンは2、 4ートリルジアミ

ンと 2. 6 - トリルジアミンとの混合物、特に約80 重量%の 2. 4 - トリルジアミンと約20 重量%の 2. 6 - トリルジアミンとの市販の混合物である。

ボリマー鎖中で非対称ではないジアミンの約25 重量%までの少量がボリイミドシロキサン組成物 中に使用し得る。このようなその他のジアミンは 米国特許第4、395、527 号及び同第4、586、997 号に 開示されており、その開示は本明細書中に参考と して含まれる。

このような補助のジアミンは、次式を有する。

(式中、 x はジグライム、 T H K または M E K 中

ましい。更に、xはまたNMP中の溶解性のみを

ーCH2ーであってもよい。)

付加的な有機ジアミンは、熱安定性及びガラス転移温度の有利な組合せに影響せずに極めて少量で使用することができ、溶解性が見られる。

## シロキサンモノマー

本発明に使用し得るシロキサンジアミノ化合物 は次式を有する。

$$H_{2}N-R' \leftarrow \begin{pmatrix} R_{1} \\ S_{1} \\ S_{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{R_{2}} \begin{pmatrix} R_{2} \\ S_{1} \\ R_{3} \end{pmatrix}$$

(式中、R、、R、、R、及びR。は独立に1~12個の炭素原子の置換もしくは無置換の脂肪族の一価の基または6~10個の炭素原子の置換もしくは無置換の芳香族の一価の基である。)

好適な基は、-CH<sub>2</sub>、-CF<sub>2</sub>、-(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>CF<sub>3</sub>、 -C<sub>n</sub>H<sub>2</sub>、-CF<sub>2</sub>-CHF-CF<sub>3</sub>及び - CHz - CHz - C - O - CHzCFzCFzCFzを含む。

R'は上記の型の二価の基である。好適な二価の基は、(CHz)、(CFz)、 - (CHz)、(CFz)、 - 及び- CsHz - (式中、m及びnは1~10である)を

る。しかしながら、高ガラス転移温度のポリイミドシロキサンをつくるためには、全ジ酸無水物中のジ酸無水物の混合物のモル%は最大にすべきである。それ故、 6 F D A 及びその混合物と有機ジアミン及びα、ωージアミノシロキサンとの組合せを使用することが更に望ましい。

本発明の実施のため、シロキサンジアミンに代えて、またはそれらに加えて混入し得るシロキサンジ無水物は、次式を有し得る。

$$\begin{array}{c|c}
\overrightarrow{R} & \overrightarrow{0} \\
\overrightarrow{0} & \overrightarrow{R} & \overrightarrow{0} \\
\overrightarrow{0} & \overrightarrow{0} & \overrightarrow{0}
\end{array}$$

(式中、R」、R』、R』及びR。は独立に1~12個の炭素原子の置換もしくは無置換の脂肪族の一価の基または6~10個の炭素原子の置換もしくは無置換の一価の基である。)

好適な基は、-CH。、-CF。、-(CH2)aCF。、

Rは上記の型の三価の基である。好適な三価の基は、

を含む。

6 F D A 以外のジ酸無水物が使用される場合には、種々の溶媒中のそれらの溶解性、ガラス転移温度及び熱安定性はこれらのコモノマーの化学的性質に応じて変化する。例えば、シロキサンジ酸無水物が6 F D A の存在下で混入される場合には、ポリマーの溶解性は増大し、一方ガラス転移温度及び熱安定性は低下される。従って、用途の契件に応じて、シロキサンジ酸無水物の混入が不幾少酸無水物が5 モル%未満の少量で添加される場合に

#### 可溶性ポリイミドシロキサンの製造方法

有機ジアミンと有機ジ酸無水物との反応の化学 は公知となっているが、シロキサンコモノマーの 存在下のポリイミドシロキサンの調製は時として 特別な技術を要することがある。例えば、シロキ サンモノマーの反覆単位mが一層大きい(即ち > 20~40)の場合には、二成分溶媒系、即ち 極性溶媒のみならず一層極性がない溶媒からなる

溶媒系を使用することが望ましいことがある(例 えばマクグラス (McGrath ) ら著、Polymer Preprints、27巻、2号、1986年、403頁を 参照のこと)。また、可溶性ポリイミドを製造す る実施に於いて、ポリイミドはポリアミド酸が可 溶性ではない所定の溶媒に可溶性である場合には 一工程重合法、即ち一工程法と称される同時のイ ミド化及び重縮合法によりポリイミドを直接調製 し得ることが知られている。この操作は、特に被 覆物用の所望のポリマー溶液が、ポリアミド酸が 可溶性ではない所定の溶媒からつくられる必要が ある時に、有利であり得る。同時のイミド化及び 重縮合に関する問題はイミド化工程中に生成され る水の存在下に於けるポリアミド酸の解重合が極 めて苛酷であり得ることである。理論的には、解 重合はジカルボン酸及びアミノ化合物を生成する ので、不可逆的なプロセスになり得る。カルボン 酸は、室温に於けるジ酸無水物とアミノ化合物と の殆ど瞬時の反応に較べて極めて高温でアミノ化 合物と反応する。ポリアミド酸の解重合は高温で

極めて苛酷になり得る。この一工程法は、ポリアミド酸及びイミド化ポリマーの両者が可溶性である良溶媒中で生成されたものに較べて極めて低い分子量をもつポリイミドシロキサンをしばしば生成し、そこで二工程方法が使用される。二工程法は極めて高分子量のポリアミド酸を生じる低温重縮合工程及びイミド化しついでイミド化から生じた水を除去する非常に速い加熱工程を用いる。

添加し得る。トルエンの如き共沸剤の使用は反応器中に存在する水の除去を容易にしポリアミド酸の解重合を最小にする。共沸剤が使用される場合には、新しい共沸剤の連続的な回収が冷却器の下にディーン・スターク(Dean Stark)トラップを用いることにより達成し得る。

キサンが使用される場合には、有機ジアミンの存 在なしで有機ジ酸無水物をまず反応させることが 有利であることが時として見られる。この操作は 二成分溶媒系を使用する必要を解消するのみなら ず、一層一様で、しかも調節可能なポリイミドブ ロックの大きさ及び分布をもたらし得る。同じ化 学処理によるが異なる添加順序(即ち、全モノマ - を一緒に溶媒中に一度に添加する)で調製され たポリイミドシロキサンに較べて、一層一様で、 しかも調節されたイミドの大きさ及び分布をもつ ポリィミドシロキサンはシロキサンに似た溶媒ま たは非極性溶媒に対して一層可溶性の特性を有し . ている。一方、ポリイミドシロキサンはイミドブ ロックの同じ平均分子量を有するが、広い分子量 分布を有するとジグライムまたはTHFに一層可 溶性でなくなる。

種々の用途の適当な要件に応じて、ポリイミドシロキサンをそれらの組成により設計し得るが、またモノマー添加順序によりそれらのミクロ構造を有利に調節し得る。

また、特にイミドプロックのガラス転移温度が 約200℃より低いか、または大きい比率(>25 %)のシロキサンコモノマーが使用される場合に は、ポリイミドシロキサンが溶融重合法で調製し 得る。実際には、溶融重縮合は、イミド化が出口 ノズルに近く位置されるベント式帯域を用いて行 ない得る押出機中で行ない得る。

高分子ポリイミドシロキサンを得るには、一種 以上のジ酸無水物成分の合計モル数が一種以上の ジアミン成分の合計モル数と等しくすべきである。 分子量を低下するには、ジ酸無水物成分、ジアミ ン成分の過剰量または少量の一官能化合物が使用 し得る。

シロキサンモノマーがジアミンである場合、使 用されるシロキサンジアミン各1モルに対してn モルの有機ジアミンが使用されると仮定する。そ の時、n+1モルの有機ジ酸無水物が使用される。

シロキサンモノマーがジ酸無水物である場合、 使用されるシロキサンジ酸無水物各1モルに対し てnモルの有機ジ酸無水物が使用されると仮定す る。その時、n+lの有機ジアミンが使用されな ければならない。

上記の場合に於いて、nは0.01より大きく40 以下、好ましくは20以下の値を有する。

0.01≤n≤0.1の場合、ポリイミドシロキサ

入用途及びシール用途に有用である。特に、架橋 性の弾性ポリイミドシロキサンは前記の用途に於 いて至大な価値を有する。0.1≤ n≤10の場合、 熱可塑性の弾性の性質をもつポリイミドシロキサ ンが得られる。これらの物質は、ワイヤー、ケー プル、射出成形用途及び保護被覆用途に有用であ る。10≤n≤40の場合、非常に高強度で硬質 の熱可塑性プラスチックが生成され、これらは成 形用途及び被覆用途に有用である。 硬化性ポリイミドシロキサン

ンは弾性またはゴムの性質を示し、注封用途、封

上記の可溶性ポリイミドシロキサンは多くの価 値のある性質及び用途を有している。しかしなが ら、それらの用途、特に一層高い耐薬品性及び耐 クリープ性が望ましいか、または重要である領域 には制限がある。例えば、殆どのポリイミドシロ キサンは、それらのシロキサン含量が30~40 %を越える時、限られた耐作動液または耐ジェッ ト燃料を示す。この弱点はフッ素化化合物をそれ らの骨格構造、特にシロキサンプロック中に混入

することにより大巾に波少し得るとしても、一層 大きい耐溶剤性及び耐クリープ性を得るためには これらのフッ素化ポリイミドシロキサンを熱硬化 性に変換することが更に一層望ましい。一般に、 架橋性ポリイミドシロキサンがアクリル官能基を 有している場合には熱的方法または光による方法 のいずれかで硬化し得る。感光性または光硬化性 ポリイミドシロキサンはミクロチップまたは集積 回路工業に於けるパターン化 (patterning) 用途 に特に価値がある。

更にまた、これらの新規な硬化性ポリイミドシ ロキサン並びに可溶性ポリイミドシロキサンは電 気工英及びマイクロ電子工業に於いてパッシベー ション層、α粒子パリヤー、電子ピームパターン 化、イオンインプラントマスクまたは層間誘電体 に用途があり得る。

本発明のポリイミドシロキサンは架橋し得る官 能基を有する反応体またはポリマーの生成後に架 橋性基で適当に変性し得る中間官能基を有する反 応体の導入により硬化性にし得る。必要とされる

官能基は好適なジアミン及び/またはシロキサン 化合物の使用により本発明のポリマー中に混入し 得る。

ジアミン化合物はポリイミドシロキサン鎖中に 非対称構造を与えるジアミンの可溶性ポリマーに ついて記載された特性を有する。更にジアミンは、 下記の一般式を有する。

(式中、Arは芳香族基であり、R "はヒドロキシ ル、ヒドロチオールまたはカルボキシル基、好ま しくはヒドロキシル基またはカルボキシル基であ

これらの化合物の代表例は、例えば3、5-ジ アミノ安息香酸及び3,5-ジーアミノフェノー ル等である。

官能化シロキサンジアミンまたはジ酸無水物は 下記の一般構造式を有する。

(式中、 D はアミノ 基または酸無水物基のいずれかであり、 R 「は前記の如き二価の基 R ′ または三価の基 R である。)

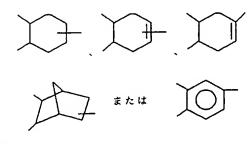
Dが酸無水物基である場合、RI、RI、RI 及びRIの一つ以上がハロゲン、ハイドライド (H)、ビニル基またはヒドロキシル基であり得、 Dがアミノ基である時にはビニルまたはヒドロキ シルであり得る以外は、RI基、RI基、RI基 及びRI基は前記のとおりである。

官能化シロキサンα、ω-ジアミノ化合物の例は下記のものであり得る。

(式中、nは  $2 \sim 6$ 、好ましくは 3 及び 4 の整数 であり、R "はピニル基またはヒドロキシル基であり、 $x + y = 1 \sim 1$  0 0、好ましくは  $4 \sim 4$  0 であり、yは  $1 \sim 1$  5、好ましくは  $1 \sim 5$  の整数 である)

官能化ジ酸無水物の例は、下記のとおりである。

(式中、R'は



であり、

Rではハイドライド (H) 、ヒドロキシル基、 ハロゲン及びピニル基、好ましくはH及びピニル 基であり、×及びyは上記と同じ意味を有する) 硬化性ポリイミドシロキサンの製造方法

可溶性ポリィミドシロキサンをつくる操作は一般には次のとおりである。

コモノマーは一般にはNMPまたはジグライムの如き適当な溶媒中で共重合される。ついで、上記の官能基の少なくとも一種を有する充分にイミド化されたポリイミドシロキサンはアセチレン含有化合物、エチレン含有化合物、またはアクリル含有化合物と更に反応させられるか、あるいはグ

ラフト化され本発明に所望な最終生成物を得る。 グラフト化反応は非反応性溶媒、好ましくはジグ ライム、THFまたはMEKで行なわれることが 好ましい。官能化ポリイミドシロキサンに選ばれ 得る多くの種々の官能基があるので、本発明に必 望なグラフト化反応はそれに従って代えられる必 要がある。例えば、カルボキシルまたはヒドロキ シル含有ポリイミドシロキサンがまず調製される 場合には、アクリル基のグラフト化は、

$$CH \xrightarrow{O} CH \xrightarrow{n} O - C \xrightarrow{CH} CH$$

$$CH \xrightarrow{O} CH \xrightarrow{n} O - C \xrightarrow{H} CH$$

$$CH \xrightarrow{O} CH \xrightarrow{n} O - C \xrightarrow{H} CH$$

$$CH \xrightarrow{O} CH \xrightarrow{n} O - C \xrightarrow{H} CH$$

$$CH \xrightarrow{O} CH \xrightarrow{n} O - C \xrightarrow{H} CH$$

$$CH \xrightarrow{O} CH \xrightarrow{N} O - C \xrightarrow{N} CH$$

$$CH \xrightarrow{O} CH \xrightarrow{N} O - C \xrightarrow{N} CH$$

$$CH \xrightarrow{O} CH \xrightarrow{N} O - C \xrightarrow{N} CH$$

$$CH \xrightarrow{O} CH \xrightarrow{N} O - C \xrightarrow{N} CH$$

$$CH \xrightarrow{O} CH \xrightarrow{N} O - C \xrightarrow{N} CH$$

$$CH \xrightarrow{N} O - C$$

$$CH$$

CH.

の如きエポキシ含有アクリレート、または

$$0 = C = N$$

$$0 = \frac{0}{C}$$

$$C \parallel_{3}$$

$$(n = 0 - 2)$$

の如きイソシアネート含有アクリレートのいずれ かを使用することにより行ない得る。

ポリィミドシロキサンの官能基がシロキサンプロック中に位置される場合には、グラフト化反応はヒドロシリル化反応または縮合反応のいずれか

を用いて行ない得る。例えば、
$$\begin{pmatrix} CH_3 \\ I \\ Si-0 \end{pmatrix}$$
 基が

ポリィミドシロキサン中に存在する場合には、グラフト化はヒドロキシリル化、即ち白金触媒の如き触媒の存在下のビニル基とSiーH基との反応により行ない得る。従って、下記の式の化合物のグラフト化はアクリレート含有ポリイミドシロキサンをもたらす。

キサンに変えられてもよい。しかしながら、この 種のグラフト化反応は適当な薬品がないため行な い難い。

イミドプロック中に存在する官能基をもつ官能 化ポリイミドシロキサンを調製するには、OH含 有ジアミノ化合物または - COOH含有ジアミノ 化合物を用いて開始することが好ましい。一方、 この種のシロキサンモノマーは通常容易に入手し 得ない。エポキシ、水紫化ケイ素基、またはケイ 君ヒドロキシル基の混入は、α. ωージアミノシ ロキサンまたはα、ω-ジ酸無水物シロキサンと 環状ケィ素エポキシ化合物、水素化ケイ素化合物 またはケイ素ヒドロキシ化合物との平衡化により 行ない得る。いずれにしても、所望のポリイミド シロキサンを製造するにはアクリル性、エチレン 性またはアセチレン性のジアミノ化合物もしくは ジ酸無水物化合物を使用するよりもアクリル基、 エチレン基またはアセチレン基をグラフト化する ことが好ましい。これは高温でのポリイミドシロ キサンのイミド化 (溶媒中約160~170℃で

エチレン基がポリイミドシロキサンのシロキサンプロック中に存在する場合には、それはそのまま使用され、更に遊離基架橋反応により然的に硬化されてもよく、あるいは更にアクリル基またはアセチレン基のいずれかを有するポリイミドシロ

2時間)中のこれらの官能基の熱による架橋反応を避けるためである。上記の官能基にのグラフト化反応は一般に非常に低い温度で行ない得る。の日本またには一般に非常に低白金触媒の存在下で25℃には度の低い温度で行ない得る。の日本またたは、といりのは基との間の縮合は触媒との時間以内で行なうことができ、一方、の日基にのなりで行なうことができ、一方をとの間のルポキシル基とイソシアネート基との間の反応は更に低い温度(室温~80℃)を必要とする。

溶媒から反応生成物を単離する必要を避けるため、被覆操作に許容し得る溶媒中でグラフト化反応を行なうことが望ましい。これらの種類の望ましい溶媒はジグライムまたはMEKの如き低燃性及び/または低毒性の溶媒である。後者は低沸点であるので被覆工業に広く使用されている。

本明細書中、ハロゲンはブッ素、塩素、臭素及びョウ素を云うが、好ましくはフッ素及び塩素を云う。芳香族化合物は一般に炭化水素芳香族化合

物を云う。

以下の実施例及び明細書中、特にことわらない 限り部は重量部であり温度はでである。

#### <u>実施例</u>

例 1

150 mlのエーレンマイヤーフラスコ中に
2、2-3′、4′-6FDA4.42g及び1メチルー2ーピロリジノン(NMP)25 mlを
仕込んだ混合物を磁気復拌機で30分混合した。
ついでp、pーオキンジアニリン(ODA)2.0
gを添加し反応を16時間行なった。生成溶液を
テフロン型中で145℃±5℃で4時間ついで
250℃で0.5時間注型した。脆いフィルムが得られた。生成物を式(FO)。で示した。

例 2

2. 2-3′. 4′-6 F D A 4. 4 2 g 及び 2. 4-トリルジアミン (2. 4-T D A と称する) 1.2 2 g を用いて例 1 を繰り返した。生成物 は脆いフィルムを形成した。生成物を式 (F T) a で示した。

にシロキサン G a. 1 s 4. 1 3 g と 2 時間反応させ、ついで 2 . 2 - 3 ′ . 4 ′ - 6 F D A 2. 2 2 g と 更に 2 時間反応させ、最後に 2 . 4 - T D A 1.22 g と 1 6 時間反応させることにより例 3 を繰り返した。 得られる生成物は可提性フィルムを形成した。 生成物を式 ((F1/3 B ′ 2/3 T) 2 G a. 1 s) で示した。

#### **6**9 6

2. 2-3 '. 4 '-6 F D A 2. 9 6 g、3.
3 '. 4, 4 '-B P D A 1. 9 6 g、C a. 7s 2.75
g 及び 2. 4-T D A 1. 2 2 g を用いて例 5 を繰り返した。反応生成物は可提性フィルムを形成し、(F ½ B ' ½ T) 3 C a. 7s として示した。

#### *19*4 7

2. 2-3'. 4'-6FDA2.96g、G<sub>\*</sub>.7<sub>5</sub>4.13g、4.4'-0DPA(オキシジフタル酸無水物)4.14g及び2.4-TDA
1.83gを用いて例3を繰り返した。得られた生成物は可提性フィルムを形成した。生成物を式((F1/3 O2/3T)<sub>3</sub>C<sub>\*</sub>.7<sub>5</sub>)で示した。

194 3

150 m & のエーレンマイヤーフラスコ中に
2、2-3′、4′-6FDA4.44g及びNーメチルピロリドン(NMP)25 m & を仕込んだ。
混合物を磁気攪拌機で30分混合した。ついでシロキサンC。.・s 1.65gを混合物に添加し、反応を2時間続けた。ついで2、4-Fリルジアミン(2、4-TDAと称する)0.976gを添加し反応を16時間行なった。生成溶液をテフロン型中145で±5でで4時間、ついで250でで
0.5時間注型した。可提性フィルムが得られた。
生成物を式((FT)4C。.・s)で示した。

69 4

2, 2-3′, 4′-6FDA4.41g、シロキサンC<sub>•.75</sub>2.48g及び2, 4-TDA0.842gを用いて例3を繰り返した。得られた生成物は可提性フィルムであった。生成物を式((FT)<sub>2.2</sub>C<sub>•.75</sub>)で示した。

<u>F9 5</u>

3.3′.4,4′-BPDA2.94gを最初

**B** 8

2. 2-3′, 4′-6FDA1.31g、3.3′.4.4′-BTDA1.90g、シロキサンCo.1,2.43g及び2.4-TDA0.722gを用いて例3を繰り返した。得られる生成物は可提性フィルムを形成した。生成物を式

((F1/3 B2/3T)<sub>2</sub>C<sub>8.75</sub>)で示した。

**M** 9

4, 4′-О D P A 1 2.9 1 g、 G e. 7 s 1 0 g 及び 2, 4-T D A 3.6 3 4 g を用いて例 5 を繰 り返した。得られる生成物は可挠性フィルムを形成した。生成物を式 (O T) z. s G e. 7 s で示した。

上記の例に於いて、Gmは

(式中、mは、表1中例えばG。. 15として示されるように反覆単位の数を示す)

#### を有する。

# 溶解性に関する試験

ジグライム 3 m ℓ 中に、試料約 0.3 g を仕込み、ついで 7 0 ~約 9 0 ℃に 2 ~ 1 6 時間加熱した。 溶解性を記録し、衷 1 に表示する。

表 1\_

6	F	D A	含	有	#	IJ	1	\$	ř	<u>シ</u>	D	+	サ	×	の溶	解性
---	---	-----	---	---	---	----	---	----	---	----------	---	---	---	---	----	----

例番号	組	溶解性/ジグライム
1	(FO) m	有
2	(FT) n	有
3	(FT) 4G . 75	有
4	(FT) z. zG e. 75	有
5	(F1/2B' 1/3T) 1Ge. 75	有
6	(F1/28' 1/2T) 2Ga. 75	有
7	(F,/302/3T) 3Ga. 75	有
8	(F1/182/3T) 2G1. 75	無
9	(OT) 2. sG e. 75	有

上記の例の生成物の幾つかを熱重量分析器中で

の被覆物は下記の領域に於いて半導体装置の製作に使用し得る。a)保護上塗として、b)多重レベル装置用の層間誘電体として、c)α粒子パリヤーとして、及びd)ノン-インプラントマスクとして。

これらの用途はリー (Lee)及びクレイグ(Craig) 著 "Polymer Materials for Electronic Applications" (ACS Symposium, Ser, 184, 108頁) に詳細に記載されている。

本発明のポリイミドシロキサンのその他の用途 はワイヤー及びケーブルの被覆物、繊維及びフィ ルム、及び成形品及び押出成形品を含む。 窒素雰囲気中400℃の温度に1時間さらした。 重量損失を測定し表2に示す。

		表2	
_	例 否 号	重量損失	(%)
2	(対照)	9.	0
6		4.	2
7		6.	5
9	(対照)	1 0.	3

THFまたはジグライムの如き、低沸点の非極性溶媒中の本発明のポリイミドシロキサンの溶解性はポリイミドシロキサン中のシロキサン成分の比率の関数であり、またシロキサンプロックの大きさの関数である。

本発明のポリイミドシロキサンはマイクロ電子 工業に於いて種々の用途に有用である。このよう な用途は被覆物の形態で誘電体として、及び/ま たは半導体及び薄膜ハイブリッド用パッシベーションとしての用途を含む。ポリイミドシロキサン

手 続 補 正 書 (方式)

平成 年 1 6 9 日

特許庁長官 吉田文段 股

1.事件の表示 平成1年特許顯第30911号

2.発明の名称 新規な可溶性ポリイミドシロキサン 及びそれらの製造方法並びに使用方法

3. 補正をする者

事件との関係 出願人

名 称 オクシデンタル ケミカル コーポレーション

4.代 理 人

住 所 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号 電話(代)211-8741

氏 名 (5995) 弁理士 中 杉

5. 補正命令の日付 平成1年5月3月

6.補正の対象 明 細 書

7.補正の内容 別紙の通り

方式 古願きに最初に添付した明細寺の浄き ・ 変 (内容に変更なし)